

## Information

Nr.21/2011  
18.7.2011



### International Thermal Spray Conference 2011 setzt auf praktische Anwendungen

DÜSSELDORF. Vom 27. bis 29. September 2011 findet die International Thermal Spray Conference & Exposition (ITSC) in Hamburg statt. Bei der englischsprachigen Fachtagung berichten Experten über Schlüsseltechnologien des thermischen Spritzens und tauschen Fachkenntnisse aus. Die ITSC zeigt Potenziale für thermisch gespritzte Schichten und informiert interessierte Anwender. Dazu nutzt die Veranstaltung das moderne Konzept der Vernetzung weltweit renommierter Konferenzen und Ausstellungen der Füge-, Trenn- und Beschichtungsbranche – in diesem Jahr den DVS Congress und die DVS Expo in Hamburg. Die ITSC 2011 legt ihren Schwerpunkt auf praxisnahe Anwendungshighlights: Unter anderem werden maritime Technologien als Beispiel für wachsende und zukünftige Anwendungen des thermischen Spritzens vorgestellt.

Unter dem Motto „verschiedene Tage, verschiedene Märkte“ wartet die fünfzügige ITSC 2011 mit insgesamt über 200 Vorträgen auf. Im Vordergrund stehen Anwendungen und Entwicklungen in den Bereichen Automobilbau, Luft- und Raumfahrttechnik, Gasturbinen, Medizintechnik und tribologische Schichten. Zusätzlich werden auch Nachwuchswissenschaftler ihre aktuellen Ergebnisse in der Vortragsreihe „Young Professionals“ vorstellen.

Am zweiten und dritten Tag laden die Veranstalter zu einer Posterschau mit über 160 Objekten ein. Die Autoren sind dabei vor Ort und stehen für Fragen und Diskussionen zur Verfügung.

Ein wesentliches Ziel der Fachtagung ist die praxisnahe Verbindung von Forschung, Technik und Qualifizierung auf dem Gebiet des thermischen Spritzens. Veranstalter sind der DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V., die ASM Thermal Spray Society (TSS) und das International Institute of Welding (IIW). Die drei Vereinigungen wollen insbesondere das Interesse der

## DVS

DVS – Deutscher Verband für  
Schweißen und verwandte  
Verfahren e.V.

Aachener Str. 172  
40223 Düsseldorf

Fon +49.(0)211.1591-301  
Fax +49.(0)211.1591-300  
tagungen@dvs-hg.de  
www.die-verbindungs-  
spezialisten.de

**MESSE  
ESSEN**  
Place of Events

MESSE ESSEN GmbH

Postanschrift  
Postfach 10 01 65  
45001 Essen

Hausanschrift  
Messehaus Ost Norbertstraße  
45131 Essen

Fon +49.(0)201.7244-244  
Fax +49.(0)201.7244-249  
presse@messe-essen.de  
www.messe-essen.de

Veröffentlichung kostenfrei –  
Beleg erbeten

Unternehmen für einen ganzheitlichen technisch-wissenschaftlichen Informationsaustausch wecken.

Die Veranstalter erwarten über 2.000 Teilnehmer zum DVS Congress und zur DVS Expo und rufen alle Unternehmen, Forscher und Ausbilder auf dem Gebiet des thermischen Spritzens dazu auf, zur Veranstaltung in Hamburg zu kommen! Der Tagungsband mit allen Vorträgen zu ITSC und DVS Congress wird bei der DVS Media GmbH erscheinen und auf dem Kongress als Printversion sowie als USB-Stick erhältlich sein. Informationen dazu sowie die Möglichkeit einer Online-Registrierung gibt es im Internet unter [www.dvs-congress.de/itsc2011](http://www.dvs-congress.de/itsc2011). Alle Vorträge und Veranstaltungen außerhalb der ITSC sowie des Forschungskolloquiums zum thermischen Spritzen finden in deutscher Sprache statt.

**Ihre Ansprechpartnerin zur ITSC und zum DVS Congress:** Simone Mahlstedt, Tel.: 0211 1591-302, E-Mail: [simone.mahlstedt@dvs-hq.de](mailto:simone.mahlstedt@dvs-hq.de)

**Für Ihren Terminkalender:**

Wann?	Was?	Wo?	Web:
26.- 29.09.2011	<b>DVS Congress und DVS Expo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Große Schweißtechnische Tagung 2011</li> <li>▪ DVS-Studentenkongress 2011</li> <li>▪ 12. Sondertagung „Schweißen im Schiffbau und Ingenieurbau“</li> <li>▪ Sondertagung Unterwassertechnik 2011</li> <li>▪ Roboter 2011 – Wirtschaftliche Fertigung durch fügetechnische Automatisierung</li> <li>▪ Abschlusskolloquium zum AiF/DFG-Forschungscluster „Lichtbogenschweißen – Physik und Werkzeug“</li> <li>▪ Abschlusskolloquium zum AiF/DFG-Forschungscluster „Thermisches Spritzen – Eine Schlüsseltechnologie für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit – Oberflächenschutz am Beispiel der Druck- und Papierindustrie“</li> </ul>	Hamburg	<a href="http://www.dvs-congress.de/2011">www.dvs-congress.de/2011</a>  <a href="http://www.dvs-expo.de/2011">www.dvs-expo.de/2011</a>
27.- 29.09.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ITSC 2011 International Thermal Spray Conference &amp; Exposition</li> </ul>		<a href="http://www.dvs-congress.de/itsc2011">www.dvs-congress.de/itsc2011</a>



Die ITSC 2011 findet im Rahmen des DVS Congress und der DVS Expo in Hamburg statt. Letztes Jahr trafen sich rund 500 Teilnehmer zu der Fachveranstaltung rund um das thermische Spritzen in Singapur.  
Bild: DVS